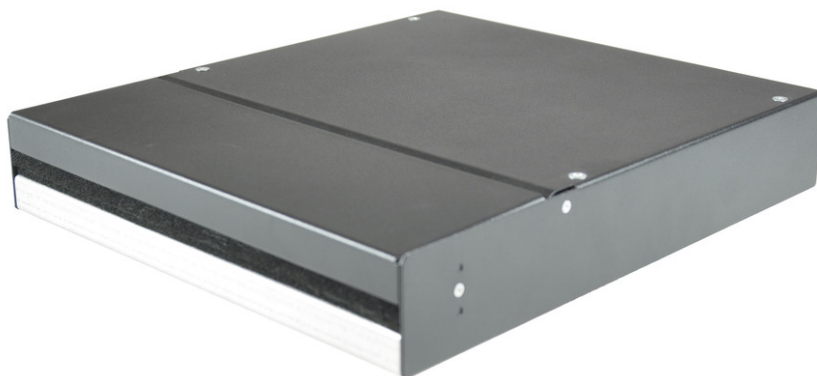


tML® - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, grau



## tML® - tde Modular Link

tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML®-Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® Xtended System, tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

- Formschönes Gehäuse für Wand-, Decken- und Bodenmontage
- LWL- und Kupferanwendungen
- tML® kompatibel



**tde® trans data elektronik GmbH**

### Hausanschrift:

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

### Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 8805 61 13  
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

## tML<sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, grau

- Aufbau für die verschiedensten Anwendungen
- Kabel Ein- und Ausgang (Einzelzugentlastung) möglich

### Technische Daten

|             |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse     | Für 10" bestehend aus: Bodenschale mit beidseitiger Zugentlastung und Deckel mit Staubschutzklappe und Dichtlippen |
| Frontplatte | für bis zu 4x CU- oder LWL-Module                                                                                  |
| Abmessungen | 50 x 260 x 300 mm (HxBxT)                                                                                          |
| Material    | Stahl 1203                                                                                                         |
| Farbe       | RAL 7035 (grau)                                                                                                    |

### Artikelvarianten & Zubehör

| Art.-Nr.           | Beschreibung                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TML-CONS10/1HE-GR  | tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, grau    |
| TML-CONS10/1HE-SW  | tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 4x CU- oder LWL-Module, schwarz |
| TML-CONS19/1HE-GR  | tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, grau    |
| TML-CONS19/1HE-SW  | tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 8x CU- oder LWL-Module, schwarz |
| TML-CONS3HE/8TE-GR | tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, grau    |
| TML-CONS3HE/8TE-SW | tML <sup>®</sup> - Consolidationpoint-Gehäuse für bis zu 2x CU- oder LWL-Module, schwarz |